

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2026-028

## 芯联集成电路制造股份有限公司

### 对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

投资标的名称	芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称“芯联先进”）
投资进展情况	签署《关于芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司之增资及股东协议》

#### 一、对外投资基本情况

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”或“芯联集成”）与芯联先进、浙江绍兴杭绍临空示范区产业发展集团有限公司于2026年6月9日签署了《关于芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司之合资框架协议》（以下简称《合资框架协议》）。根据《合资框架协议》，各方合资经营芯联先进，作为芯联12英寸车规级数模混合芯片制造项目（以下简称“四期项目”）的实施主体，建设一条5万片/月的12英寸集成电路车规级数模混合芯片生产线，主要技术和产品方向为40/28纳米MCU/DSP、90/55纳米BCD/DrMOS等模拟电路、55纳米硅光/激光驱动等芯片。四期项目计划总投资约200亿元，其中资本金120亿元（芯联集成拟出资30.12亿元，杭绍临空牵头组建的地方产业基金以及其他联合投资主体拟出资30亿元，其他市场化资金拟出资59.88亿元），银行贷款80

亿元。

上述事项经公司第二届董事会第十五次会议审议并通过，具体内容详见公司2026年6月12日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司拟对外投资暨签署相关协议的公告》（公告编号：2026-024）。

## 二、对外投资进展情况

近日，公司与芯联先进、绍兴柯桥芯合先进集成创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）共同签署了《关于芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司之增资及股东协议》（以下简称“《增资及股东协议》”）。根据本次《增资及股东协议》，产业基金拟向公司增资人民币200,386万元，认购公司新增注册资本人民币200,386万元；芯联集成拟向公司增资人民币66,152万元，认购公司新增注册资本人民币66,152万元。

## 三、本次《增资及股东协议》主要内容

### （一）投资主体基本情况

#### 1、绍兴柯桥芯合先进集成创业投资基金合伙企业（有限合伙）

法人名称	绍兴柯桥芯合先进集成创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330621MAKGYQRB64
成立时间	2026-06-12
注册地址	浙江省绍兴市柯桥区钱清街道群贤西路4313号培训楼905室
执行事务合伙人	深圳市合创资本管理有限公司

## 2、芯联集成电路制造股份有限公司

法人名称	芯联集成电路制造股份有限公司
统一社会信用代码	91330600MA2BDY6H13
成立时间	2018-03-09
注册地址	浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号
实际控制人	无实际控制人

### (二) 本次增资安排

#### 1、本次增资金额和本次增资完成后公司股权结构

根据本次《增资及股东协议》，产业基金拟向公司增资人民币 200,386 万元，认购公司新增注册资本人民币 200,386 万元；芯联集成拟向公司增资人民币 66,152 万元，认购公司新增注册资本人民币 66,152 万元。增资完成后，芯联先进的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本/万元	持股比例
1	产业基金	200,386	74.90%
2	芯联集成	67,152	25.10%
合计		267,538	100%

2、投资款的缴付：各方同意，就产业基金和芯联集成新增认缴的公司注册资本的投资款，将分期实缴出资。

3、投资款的用途：除本协议另有规定外，本次增资的资金全部用于项目建设、日常运营、推进主营业务的研发和生产等用途。

### (三) 股东会

股东会由公司股东依照实缴出资比例行使表决权。

### (四) 董事会

1、各方同意，公司设董事会，由四（4）名董事组成，其中由芯联集成提名一（1）名董事，产业基金提名三（3）名董事。董事会设董事长一人，由产业基

金提名担任董事长的董事担任。

2、董事会的议事规则和表决程序：董事会决议的表决，实行一人一票。上述董事会决议事项，须经出席董事会会议的过半数董事通过并作出决议方可实施。

#### （五）审计委员会

公司不设监事会，设审计委员会，为董事会下设的专门监督机构，由公司董事组成，并依照适用法律、公司章程及本协议的约定行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

#### （六）总经理

公司设总经理一（1）名，直接向董事会负责。总理由芯联集成提名，副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名。被提名的人选经董事会决定被聘任为公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员。公司其他经营管理人员由公司总经理聘任。

### 四、对上市公司的影响

本次协议的签署，符合公司长期发展战略规划，有利于加快完善公司在高端模拟集成电路芯片领域的战略布局，增强核心竞争力；有利于抓住当前 AI 算力服务器、新能源汽车、机器人、光互联等新兴产业的发展契机，推动公司主营业务持续成长。

后续公司将根据对外投资事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年6月24日